

Dell EMC PowerEdge C6420

Caractéristiques techniques

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2017- 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Table des matières

1 Présentation du système Dell EMC PowerEdge C6420.....	4
2 Caractéristiques techniques.....	5
Dimensions du module tiroir extractible C6420 Dell EMC PowerEdge C6400.....	5
Poids du châssis.....	6
Spécifications du processeur.....	6
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	6
Pile du système.....	6
Caractéristiques du bus d'extension.....	6
Spécifications de la mémoire.....	7
Caractéristiques des disques et du stockage.....	7
Spécifications vidéo.....	7
Spécifications environnementales.....	8
Spécifications de température de fonctionnement standard.....	8
Spécifications de température de fonctionnement étendue.....	16
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse.....	20
Caractéristiques de vibration maximale.....	21
Caractéristiques de choc maximal.....	21
Caractéristiques d'altitude maximale.....	21
Opération Fresh Air.....	21
3 Ressources de documentation.....	22
4 Obtention d'aide.....	24
Contacter Dell EMC.....	24
Commentaires sur la documentation.....	24
Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL).....	24
QRL (Quick Resource Locator) pour systèmes C6400 et C6420.....	25
Obtention du support automatique avec SupportAssist.....	25
Informations sur le recyclage ou la fin de vie.....	25

Présentation du système Dell EMC PowerEdge C6420

Le traîneau PowerEdge C6420 prend en charge jusqu'à deux processeurs de la gamme Intel Xeon Scalable avec 28 cœurs par processeur. Le traîneau prend également en charge des adaptateurs de carte mezzanine, PCIe et OCP dédiés pour l'extension et la connectivité.

 **REMARQUE : Le processeur Intel Xeon Scalable avec connecteur Fabric est également appelé Native Omnipath.**

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du module tiroir extractible C6420 Dell EMC PowerEdge C6400
- Poids du châssis
- Spécifications du processeur
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Pile du système
- Caractéristiques du bus d'extension
- Spécifications de la mémoire
- Caractéristiques des disques et du stockage
- Spécifications vidéo
- Spécifications environnementales

Dimensions du module tiroir extractible C6420 Dell EMC PowerEdge C6400

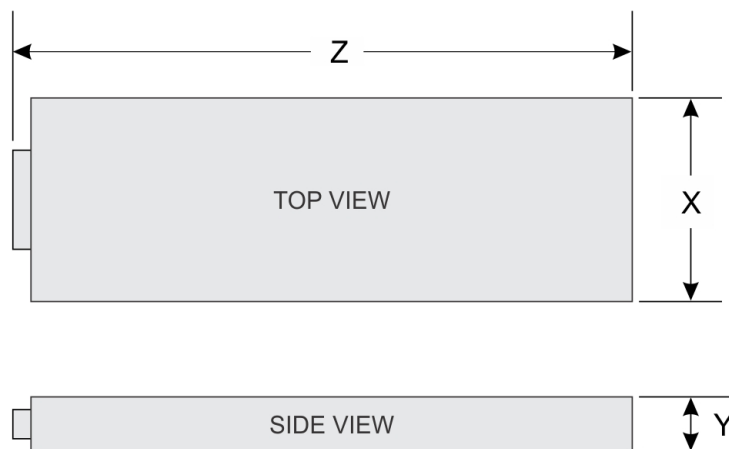


Figure 1. Dimensions du module tiroir extractible PowerEdge C6420

Tableau 1. Dimensions du module tiroir extractible PowerEdge C6420

X	O	Z
174,4 mm (6,86 pouces)	40,5 mm (1,59 pouces)	574,5 mm (22,61 pouces)

Poids du châssis

Tableau 2. Poids du châssis du boîtier avec traîneaux

Système	Poids maximal (avec tous les traîneaux et disques)
Systèmes avec 12 disques durs de 3,5 pouces	43,62 kg (96,16 lb)
Systèmes sans fond de panier	34,56 kg (76,19 lb)

Spécifications du processeur

Le module tiroir extractible Dell EMC PowerEdge C6420 prend en charge jusqu'à deux processeurs évolutifs Intel Xeon dans chacun des quatre modules tiroirs extractibles indépendants. Chaque processeur prend en charge jusqu'à 28 cœurs.

REMARQUE : Le processeur avec structure doit être installé dans le socket de processeur 2 en cas de configuration mixte contenant des processeurs avec et sans structure.

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le Dell EMC PowerEdge C6420 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Microsoft Windows Server avec Hyper-V
- Canonical Ubuntu LTS
- VMware ESXi
- Citrix XenServer

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les versions spécifiques et les ajouts, rendez-vous sur <https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420>

Pile du système

Le traîneau PowerEdge C6420 utilise une pile bouton au lithium CR 2032 3 V remplaçable.

REMARQUE : une batterie système est présente dans chaque traîneau.

Caractéristiques du bus d'extension

Le traîneau Dell EMC PowerEdge C6420 prend en charge quatre logements PCIe de 3e génération.

Tableau 3. Caractéristiques du bus d'extension

Emplacements PCIe	Description	Format
Carte de montage PCIe mezzanine x8	Logement 1 : PCIe Gen3 x8 à partir du processeur 1	Format personnalisé
Carte de montage OCP mezzanine x8 + x8	Logement 2 : PCIe Gen3 x8 à partir du processeur 1	Format standard Open Compute Project (OCP)
	Logement 3 : PCIe Gen3 x8 à partir du processeur 1	
Carte de montage principale PCIe x16	Logement 4 : PCIe Gen3 x16 processeur 1	Format standard PCIe profil bas
Carte de montage PCIe dissimulée x16	Logement 5 : PCIe Gen3 x16 à partir du processeur 2	Format personnalisé

REMARQUE : La carte de montage M.2 SATA est prise en charge sur la carte de montage encastrée.

Spécifications de la mémoire

Tableau 4. Spécifications de la mémoire

Module de mémoire Supports	Type de barrette DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	Monoprocasseur		Doubles processeurs	
				RAM minimale	RAM maximale	RAM minimale	RAM maximale
Seize à 288 broches	LRDIMM	Quadruple rangée	64 Go	64 Go	512 Go	128 Go	1 024 Go
		Huit rangées	128 Go	128 Go	1 024 Go	256 Go	2 048 Go
	Barrette RDIMM	Une rangée	8 Go	8 Go	64 Go	16 Go	128 Go
		Double rangée	16 Go	16 Go	128 Go	32 Go	256 Go
			32 Go	32 Go	256 Go	64 Go	512 Go
			64 Go	64 Go	512 Go	128 Go	1 024 Go

Caractéristiques des disques et du stockage

Le module tiroir extractible Dell EMC PowerEdge C6420 prend en charge les disques SAS et SATA et les disques SSD (Solid State Drive).

Tableau 5. Options de disque prises en charge pour le module tiroir extractible PowerEdge C6420

Nombre maximum de disques dans le boîtier	Nombre maximum de disques attribués par module tiroir extractible
12 systèmes de disques de 3,5 pouces	Trois disques SAS ou SATA et SSD par module tiroir extractible
24 systèmes de disques de 2,5 pouces	Six disques SAS ou SATA et SSD par module tiroir extractible
24 systèmes de disques de 2,5 pouces avec NVMe	Le backplane NVMe prend en charge l'une des configurations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Deux disques NVMe et quatre disques SAS ou SATA et SSD par module tiroir extractible • Six disques SAS ou SATA et SSD par module tiroir extractible
Disque M.2 SATA (en option)	La capacité de la carte SATA M.2 prise en charge est de 120 Go. REMARQUE : La carte M.2 SATA peut être installée sur la carte de montage pour carte mezzanine x8 (logement 1) ou l'emplacement pour carte de montage x16 (logement 5).
Carte microSD (en option) pour l'amorçage (jusqu'à 64 Go)	Une sur chaque carte de montage PCIe de chaque module tiroir extractible

Tableau 6. Options RAID prises en charge avec les disques M.2 SATA

Options	Disque M.2 SATA sans RAID	Deux disques M.2 SATA avec RAID matériel
RAID matériel	Non	Oui
Mode RAID	S.O.	RAID 1
Nombre de disques pris en charge	1	2
Processeurs pris en charge	processeur 1	processeur 1 et processeur 2

Spécifications vidéo

Le traîneau Dell EMC PowerEdge C6420 prend en charge une carte graphique Matrox G200 intégrée avec 16 Mo de RAM.

Tableau 7. Options de résolution vidéo prises en charge

Résolution	Taux de rafraîchissement (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1024 x 768	60	jusqu'à 24
1 280 x 800	60	jusqu'à 24
1280 x 1024	60	jusqu'à 24
1 360 x 768	60	jusqu'à 24
1440 x 900	60	jusqu'à 24

Spécifications environnementales

Les sections ci-dessous contiennent des informations sur les spécifications environnementales du système.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les certifications environnementales, veuillez consulter la fiche technique environnementale du produit qui se trouve dans la section Manuels et documents sur www.dell.com/poweredgemanuals.

Spécifications de température de fonctionnement standard

REMARQUE :

- Non disponible :** indique que la configuration n'est pas proposée par Dell EMC.
- Non pris en charge :** indique que la configuration n'est pas prise en charge thermiquement.

REMARQUE : Tous les composants, y compris les barrettes DIMM, cartes de communication, cartes SATA M.2 et cartes PERC, peuvent être pris en charge avec suffisamment de marge thermique si la température ambiante est inférieure ou égale à la température de fonctionnement continu maximale indiquée dans ces tableaux, à l'exception de la carte Mellanox DP LP et de la carte Intel Rush Creek.

Tableau 8. Spécifications de température de fonctionnement standard

Température de fonctionnement standard	Spécifications
Plages de température (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement.

REMARQUE : Certaines configurations nécessitent une température ambiante inférieure. Pour plus d'informations, consultez les tableaux suivants.

Tableau 9. Température de fonctionnement continu maximale pour une configuration à double processeur sans structurel

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces					Châssis sans BP	
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques		4 disques
205 W	8280	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	Pas de prise en charge (2 °C)	Pas de prise en charge (10 °C)	Pas de prise en charge (11 °C)	Pas de prise en charge (19 °C)	20	21	21	21	21	S.O.
	8280L	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8					20	21	21	21	21	

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP								
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques		S.O.							
	8280M	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8											20	21	21	21	21	30		
	8270	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8											20	21	21	21	21	21	30	
	8268	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8											20	21	21	21	21	21	30	
200 W	6254	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	Pas de prise en charge (6 °C)	Pas de prise en charge (14 °C)	Pas de prise en charge (15 °C)	20	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	30		
165 W	8276	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	35	35	
	8276L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
	8276M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
	8260	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
	8260L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
	8260M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
	8260C	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8											30	30	30	30	30	30	35	35
150 W	6252	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	Pas de prise en	21	23	30	30	30	30	30	30	35	35							

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP S.O.
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques	
		CPU2 : V2DRD	CPU2 : 8	charge (14 °C)									
	6248	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6244	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
125 W	6230	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP S.O.
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques	
115 W	5217	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/ Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP	
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques		
		CPU2 : V2DRD	CPU2 : 8											
	4208	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Tableau 10. Température de fonctionnement continu maximale pour une configuration à processeur unique sans structure

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/ Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP	
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques		
205 W	8280	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280L	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280M	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8270	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8268	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
200 W	6254	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
165 W	6212U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP	
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques	S.O.	
	8260C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6210U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6252	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6248	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6244	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125 W	6230	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
115 W	5217	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Enveloppe thermique (watts)	Modèle du processeur	Modèle de dissipateur de chaleur	Mémoire/Processeur max.	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces						Châssis sans BP
				12 disques	8 disques	4 disques	24 disques	20 disques	16 disques	12 disques	8 disques	4 disques	S.O.
	5215M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Tableau 11. Restrictions de configuration avec la carte Mellanox Navi double port avec connectivité active (optique)

Enveloppe thermique (watts)	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces				Châssis sans BP
	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	16 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	S.O.
205 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	23
200 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	23
173 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	24	24	28
165 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	24	25	25	26	29
160 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	24	25	26	26	30
150 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	26	27	28	28	31
140 W	Non pris en charge	23	25	28	29	29	30	33
135 W	Non pris en charge	24	25	29	30	30	31	33
130 W	Non pris en charge	24	26	30	31	31	31	34
125 W	20	25	27	30	31	32	32	35
115 W	21	27	28	32	33	34	34	>35
113 W	21	27	28	32	33	34	34	>35

Enveloppe thermique (watts)	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces				Châssis sans BP
	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	16 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	S.O.
105 W	22	28	30	34	35	>35	>35	>35
85 W	23	32	33	>35	>35	>35	>35	>35
70 W	25	34	>35	>35	>35	>35	>35	>35

Tableau 12. Restrictions de configuration avec la carte Intel Rush Creek

Enveloppe thermique (watts)	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces				Châssis sans BP
	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	16 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	S.O.
205 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	23
200 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	21	21	24
173 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	23	24	28
165 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	22	22	24	25	29
160 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	22	22	24	26	29
150 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	24	24	26	27	30
140 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	26	26	27	28	31
135 W	Non pris en charge	Non pris en charge	20	26	26	28	29	32
130 W	Non pris en charge	Non pris en charge	20	27	27	29	29	33
125 W	Non pris en charge	Non pris en charge	21	28	28	30	30	33
115 W	Non pris en charge	21	23	29	31	31	32	34
105 W	20	23	24	30	33	33	34	>35
85 W	24	26	27	34	>35	>35	>35	>35
70 W	25	28	29	>35	>35	>35	>35	>35

Tableau 13. Restrictions de configuration avec Intel NVMe SSD AIC P4800X

Enveloppe thermique (watts)	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces				Châssis sans BP
	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	16 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	S.O.
205 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge
200 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge

Enveloppe thermique (watts)	Châssis de 3,5 pouces			Châssis de 2,5 pouces				Châssis sans BP
	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	16 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	S.O.
173 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20
165 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20
160 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	25
150 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	20	25
140 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	20	20	25
135 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	20	20	25
130 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	20	20	20	25
125 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	20	25	25	25	30
115 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	25	25	25	25	30
105 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	25	25	25	25	30
85 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	30	30	30	30	>35
70 W	Non pris en charge	Non pris en charge	Non pris en charge	>35	>35	>35	>35	>35

Spécifications de température de fonctionnement étendue

Tableau 14. Fonctionnement dans la plage de température étendue

Fonctionnement dans la plage de température étendue

Fonctionnement continu

≤1 % des heures de fonctionnement annuelles

Spécifications

De 5 °C à 40 °C, entre 5 % et 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximal de 29 °C.

i REMARQUE : Si le système se trouve hors de la plage de températures de fonctionnement standard (10 °C à 35 °C), il peut fonctionner en continu à des températures allant de 5 °C à 40 °C.

Pour les températures comprises entre 35°C et 40 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 175 m au-dessus de 950 m (1 °F/319 pieds).

De -5°C à 45 °C, entre 5 % et 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximal de 29 °C.

i REMARQUE : Si le système se trouve en dehors de la plage de températures de fonctionnement standard (de 10 °C à 35 °C), il peut réduire sa température de fonctionnement (-5 °C à 45 °C) pendant un maximum de 1 % de ses heures de fonctionnement annuelles.

Fonctionnement dans la plage de température étendue

Spécifications

Pour les températures comprises entre 40 °C et 45 °C, la réduction maximale autorisée de la température est de 1 °C tous les 125 m au-dessus de 950 m (1 °F/228 pieds).

REMARQUE : Lorsque le système fonctionne dans la plage de température étendue, ses performances peuvent s'en voir affectées.

REMARQUE : En cas de fonctionnement dans la plage de température étendue, des avertissements de température ambiante peuvent être reportés dans le journal des événements système.

Spécifications de diminution de température de fonctionnement

Tableau 15. Température en fonctionnement

Diminution de température de fonctionnement	Spécifications
≤ 35 °C (95 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/300 mètres (1 °F/547 pieds) au-dessus de 950 mètres (3 117 pieds)
35 °C à 40 °C (95 °F à 104 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/175 mètres (1 °F/319 pieds) au-dessus de 950 mètres (3 117 pieds)
≥ 45 °C (113 °F)	La température maximale est réduite de 1 °C/125 mètres (1 °F/228 pieds) au-dessus de 950 mètres (3 117 pieds)

Spécifications d'humidité relative

Tableau 16. Spécifications d'humidité relative

Humidité relative	Spécifications
Stockage	HR de 5 % à 95 % avec point de condensation maximal de 33 °C (91 °F). L'atmosphère doit être en permanence sans condensation.
En fonctionnement	De 10 % à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximal de 29 °C (84,2 °F).

Spécifications de température

Tableau 17. Spécifications de température

Température	Spécifications
Stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
En fonctionnement continu (pour une altitude de moins de 950 m ou 3117 pieds)	De 10 °C à 35 °C (de 50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement.
Fresh Air	Pour plus d'informations sur Fresh Air, reportez-vous à la section Température de fonctionnement étendue.
Gradient de température maximal (en fonctionnement et en entreposage)	20°C/h (68°F/h)

REMARQUE : Certaines configurations nécessitent une température ambiante plus faible. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Spécifications de température de fonctionnement standard](#).

Restrictions thermiques

Tableau 18. Tableau des restrictions thermiques pour double processeur

Température d'entrée maximale en fonctionnement continu (°C)													
				Boîtier de 3,5 pouces			Boîtier de 2,5 pouces						Boîtier sans fond de panier
TDP (watts)	Nombre de processeurs	DPN des dissipateurs de chaleur du processeur	Logement DIMM max.	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	20 disques durs	16 disques durs	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	s.o.
165 W	6238R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	Non pris en charge			30	30	30	30	30	35	35
	6240R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	Non pris en charge	Non pris en charge		30	30	30	30	30	35	35
150 W	6230R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6226R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6208U	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
150 W	5220R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
130 W	4215R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	25	30	30	35	35	35	35	35	
125 W	5218R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
100W	4214R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Température d'entrée maximale en fonctionnement continu (°C)														
	4210R	CPU1 : 8 CPU2 : 8	CPU1 : 8 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
95 W	4210T	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	3206R	CPU1: CPU2:	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Tableau 19. Tableau des restrictions thermiques pour un processeur

Température d'entrée maximale en fonctionnement continu (°C)														
				Boîtier de 3,5 pouces			Boîtier de 2,5 pouces						Boîtier sans fond de panier	
TDP (watts)	Nombre de processeurs	DPN des dissipateurs de chaleur du processeur	Logements DIMM max.	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	24 disques durs	20 disques durs	16 disques durs	12 disques durs	8 disques durs	4 disques durs	s.o.	
165 W	6238R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6230R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6226R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6208U	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
130 W	4215R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125 W	5218R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Température d'entrée maximale en fonctionnement continu (°C)													
100W	4214R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
95 W	4210T	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	3206R	CPU1: CPU2:	CPU1:8 CPU2:8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Tableau 20. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air	Filtration de l'air du data center telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.
i REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un data center, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.	
i REMARQUE : L'air qui entre dans le data center doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.	
Poussières conductrices	L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.
i REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.	
Poussières corrosives	L'air doit être dépourvu de poussières corrosives.
Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescence inférieur à une humidité relative de 60%.	
i REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans data center.	

Tableau 21. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	<200 Å/mois d'après la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
i REMARQUE : Niveaux de contaminants corrosifs maximaux mesurés à ≤50% d'humidité relative.	

Caractéristiques de vibration maximale

Tableau 22. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,26 Grms de 5 à 350 Hz (toutes orientations de fonctionnement).
Stockage	1,88 Grms de 10 Hz à 500 Hz pendant quinze minutes (les six côtés testés).

Caractéristiques de choc maximal

Tableau 23. Caractéristiques de choc maximal

Choc maximal	Spécifications
En fonctionnement	24 impulsions de choc de 6 G en positif et négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 11 ms (quatre impulsions de chaque côté du système).
Stockage	Six impulsions de chocs consécutifs de 71 G en positif et négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 2 ms (une impulsion de chaque côté du système).

Caractéristiques d'altitude maximale

Tableau 24. Caractéristiques d'altitude maximale

Altitude maximale	Spécifications
En fonctionnement	3 048 m (10 000 pieds)
Stockage	12 000 m (39 370 pieds).

Opération Fresh Air

Restrictions de l'opération Fresh Air

- Les processeurs dont l'enveloppe thermique (TDP) est supérieure à 105 W ne sont pas pris en charge.
- Restrictions de la prise en charge des processeurs de 85 W et en deçà sans contrôleur PERC
- La configuration des disques de 3,5 pouces n'est pas prise en charge.
- Un dissipateur de chaleur de 114 mm est nécessaire pour le processeur dans le socket CPU1.
- La carte OCP (Kerby Flat) n'est pas prise en charge.
- La carte M.2 n'est pas prise en charge dans le logement de carte mezzanine DCS.
- Le disque SSD NVMe n'est pas pris en charge.
- Les barrettes DIMM et LRDIMM AEP ne sont pas prises en charge.
- Les cartes PCIe d'une puissance supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.
- Prise en charge des contrôleurs PERC H730 et H330 pour les processeurs 105 W
- Aucune restriction sur les contrôleurs PERC pour les processeurs dont l'enveloppe thermique est égale ou inférieure à 85 W.

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Pour afficher le document qui est répertorié dans le tableau des ressources de documentation :

- Sur le site de support Dell EMC :
 1. Dans le tableau, cliquez sur le lien de documentation qui est fourni dans la colonne Location (Emplacement).
 2. Cliquez sur le produit requis ou sur la version du produit.
 3. Sur la page Support produit, cliquez sur **Manuels et documents**.
- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.



REMARQUE : Vous trouverez le nom et le modèle du produit sur la face avant de votre système.

Tableau 25. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	<p>Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, reportez-vous au Guide d'Installation du Rail fourni avec votre solution rack.</p> <p>Pour d'informations sur la configuration de votre système, consultez le <i>Guide de mise en route</i> fourni avec votre système.</p>	www.dell.com/poweredgemanuals
Configuration de votre système	<p>Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le document Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide d'utilisation d'iDRAC).</p> <p>Pour plus d'informations sur la compréhension des sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le RACADM CLI Guide for iDRAC (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour iDRAC).</p> <p>Pour plus d'informations sur Redfish et ses protocoles, ses schémas pris en charge, et les Redfish Eventing mis en œuvre dans l'iDRAC, voir le Redfish API Guide (Guide des API Redfish).</p> <p>Pour plus d'informations sur les propriétés du groupe de base de données et la description des objets iDRAC, voir l'Attribute Registry Guide (Guide des Registres d'attributs).</p>	www.dell.com/poweredgemanuals
	<p>Pour plus d'informations sur les versions antérieures des documents iDRAC, reportez-vous à la documentation de l'iDRAC.</p> <p>Pour identifier la version de l'iDRAC disponible sur votre système, cliquez sur ? dans l'interface Web iDRAC > À propos.</p>	www.dell.com/idracmanuals

Tâche	Document	Emplacement
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	www.dell.com/operatingsystemmanuals
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	www.dell.com/poweredge manuals
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Server Administrator).	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Server Administrator
	Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et le dépannage de Dell OpenManage Essentials, voir le Dell OpenManage Essentials User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Essentials).	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Essentials
	Pour plus d'informations sur l'installation, l'utilisation et le dépannage de Dell OpenManage Enterprise, voir le Dell OpenManage Enterprise User's Guide (Guide d'utilisation de Dell OpenManage Enterprise)	www.dell.com/openmanagemanuals > OpenManage Enterprise
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Dell SupportAssist, consultez le document Dell EMC SupportAssist Enterprise User's Guide (Guide d'utilisation de Dell EMC SupportAssist pour les entreprises).	https://www.dell.com/serviceabilitytools
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	www.dell.com/openmanagemanuals
Travailler avec les contrôleurs RAID Dell PowerEdge	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC), les contrôleurs RAID logiciels ou la carte BOSS et le déploiement des cartes, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.	www.dell.com/storagecontrollermanuals
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur la consultation des messages d'événements et d'erreurs générés par le firmware du système et les agents qui surveillent les composants du système, consultez la section Recherche de code d'erreur.	www.dell.com/qrl
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	www.dell.com/poweredge manuals

Obtention d'aide

Sujets :

- [Contacter Dell EMC](#)
- [Commentaires sur la documentation](#)
- [Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator \(QRL\)](#)
- [Obtention du support automatique avec SupportAssist](#)
- [Informations sur le recyclage ou la fin de vie](#)

Contacter Dell EMC

Dell EMC propose plusieurs possibilités de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet active, vous trouverez les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, facture ou catalogue de produits Dell EMC. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour contacter Dell EMC concernant des questions commerciales, de support technique ou de service client :

Étapes

1. Rendez-vous sur www.dell.com/support/home.
2. Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant situé dans le coin inférieur droit de la page.
3. Pour obtenir un support personnalisé :
 - a) Saisissez le numéro de série de votre système dans le champ **Saisissez votre numéro de série**.
 - b) Cliquez sur **Envoyer**.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
4. Pour obtenir un support général :
 - a) Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b) Sélectionnez la gamme de votre produit.
 - c) Sélectionnez votre produit.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
5. Pour contacter le support technique mondial Dell EMC :
 - a) Cliquez sur [Support technique mondial](#).
 - b) La page **Contacter le support technique** qui s'affiche contient des informations détaillées sur la façon de contacter l'équipe de support technique mondial Dell EMC, par téléphone, chat ou e-mail.

Commentaires sur la documentation

Vous pouvez évaluer la documentation ou rédiger vos commentaires sur nos pages de documentation Dell EMC et cliquer sur **Send Feedback (Envoyer des commentaires)** pour envoyer vos commentaires.

Accès aux informations sur le système en utilisant le Quick Resource Locator (QRL)

Vous pouvez utiliser le Quick Resource Locator (QRL) situé sur la plaquette d'informations à l'avant du serveur PowerEdge R930 pour accéder aux informations sur celui-ci.

Prérequis

Assurez-vous que votre smartphone ou tablette a le scanner de QR code installé.

Le QRL comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, notamment le Manuel d'installation et de maintenance, et présentation mécanique
- Numéro de série de votre système pour accéder rapidement à votre configuration matérielle spécifique et les informations de garantie
- Un lien direct vers Dell pour contacter l'assistance technique et les équipes commerciales

Étapes

1. Rendez-vous sur www.dell.com/qrl pour accéder à votre produit spécifique ou
2. Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour numériser le code QR (Quick Ressource) spécifique au modèle sur votre système ou dans la section Quick Resource Locator.

QRL (Quick Resource Locator) pour systèmes C6400 et C6420



Figure 2. QRL (Quick Resource Locator) pour systèmes PowerEdge C6400 et C6420

Obtention du support automatique avec SupportAssist

Dell EMC SupportAssist est une offre Dell EMC Services (en option) qui automatise le support technique pour vos périphériques de serveur, de stockage et de gestion de réseau Dell EMC. En installant et en configurant une application SupportAssist dans votre environnement informatique, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- **Détection automatisée des problèmes** : SupportAssist surveille vos périphériques Dell EMC et détecte automatiquement les problèmes matériels, de manière proactive et prédictive.
- **Création automatique de tickets** : lorsqu'un problème est détecté, SupportAssist ouvre automatiquement un ticket de support auprès du support technique Dell EMC.
- **Collecte de diagnostics automatisée** : SupportAssist collecte automatiquement les informations d'état du système à partir de vos périphériques et les télécharge en toute sécurité sur Dell EMC. Ces informations sont utilisées par le support technique Dell EMC pour résoudre le problème.
- **Contact proactif** : un agent du support technique Dell EMC vous contacte à propos du ticket de support et vous aide à résoudre le problème.

Les avantages disponibles varient en fonction des droits au service Dell EMC achetés pour votre appareil. Pour plus d'informations sur SupportAssist, rendez-vous sur www.dell.com/supportassist.

Informations sur le recyclage ou la fin de vie

Les services de reprise et de recyclage sont proposés pour ce produit dans certains pays. Si vous souhaitez éliminer des composants du système, rendez-vous sur www.dell.com/recyclingworldwide et sélectionnez le pays concerné.